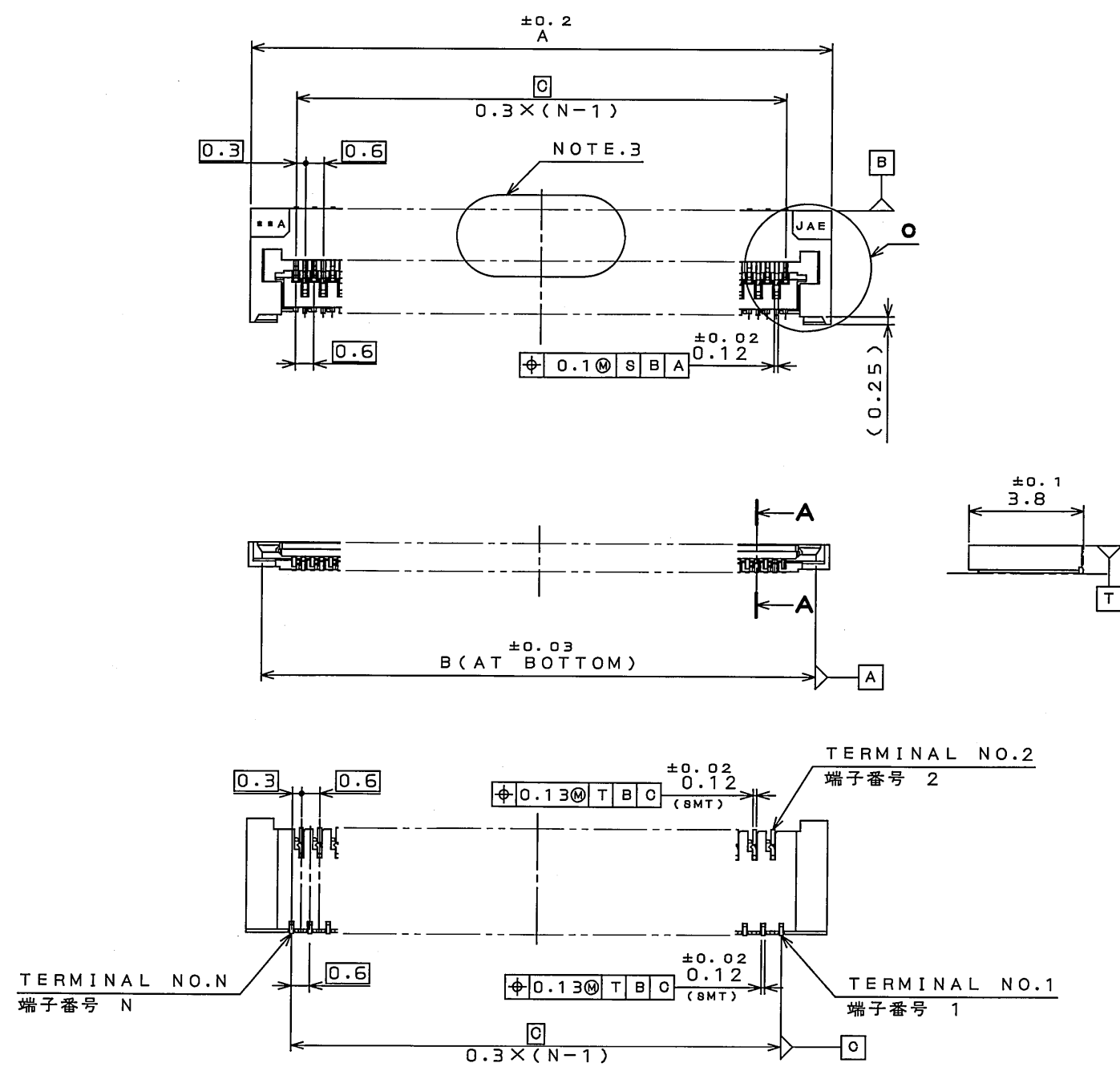
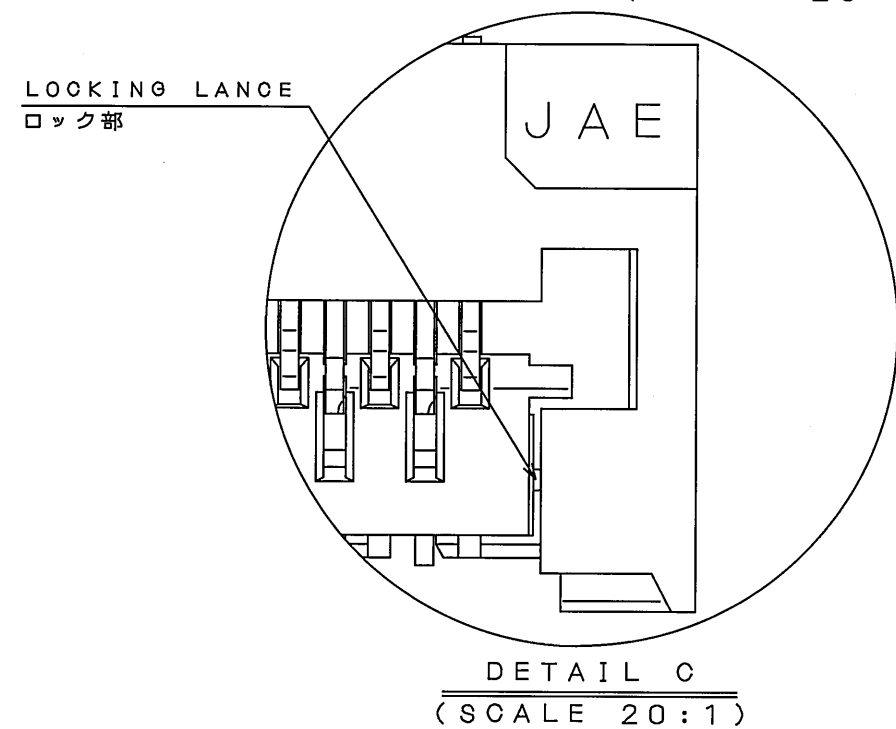
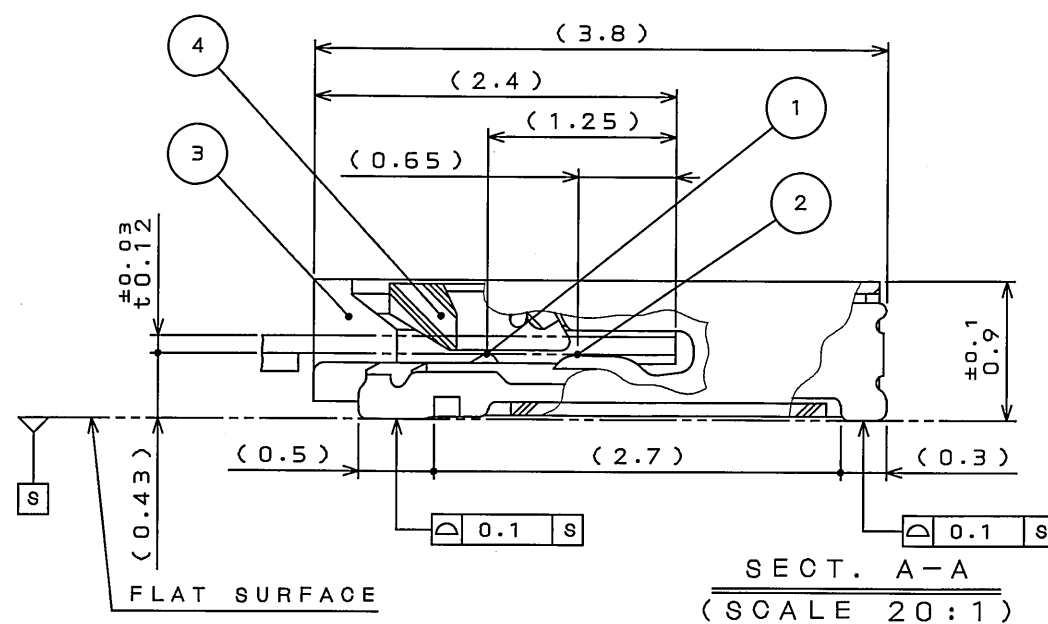
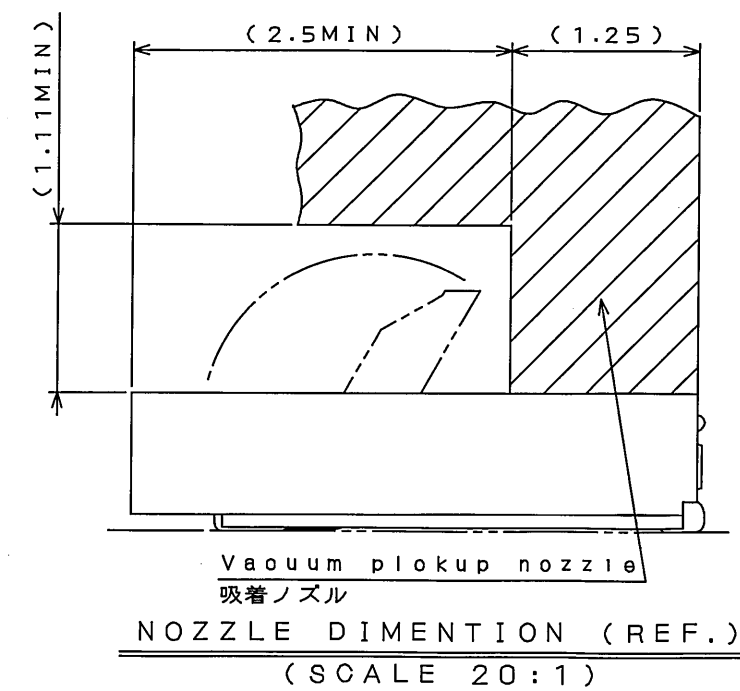


版 数 REV.	年月日 DATE	CON NO.	変 更 内 容 DESCRIPTION	製 図 DR.	担 当 CHK.	査 閲 APPD.	承 認 APPD.
2	19.Oct.2005	058469	ADDED NEW ITEMS	_____	K.INOUE	_____	O.HASHIGUCHI
3	24.Nov.2005	058588	ADDED NEW ITEMS	_____	K.INOUE	_____	O.Hashiguchi

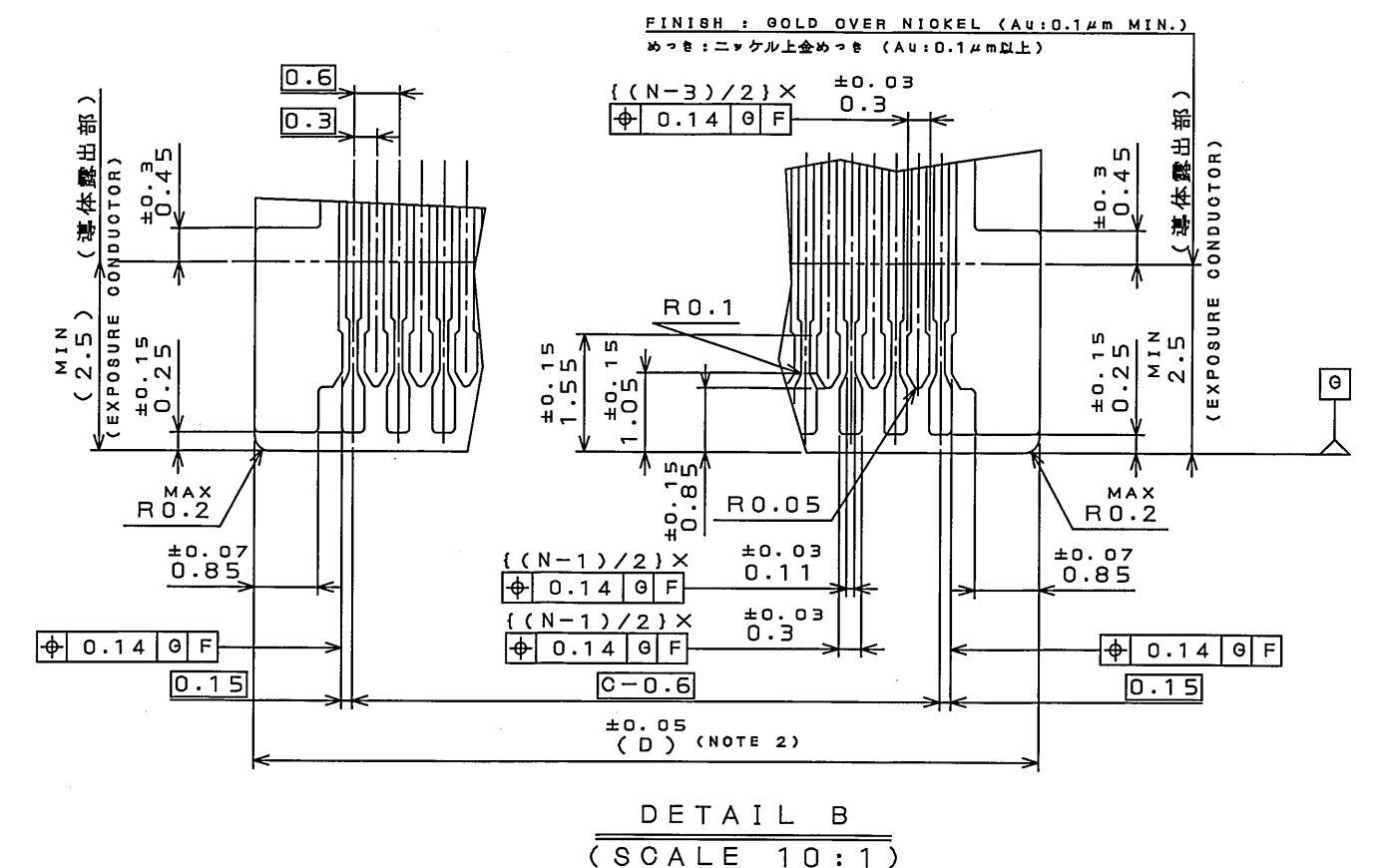
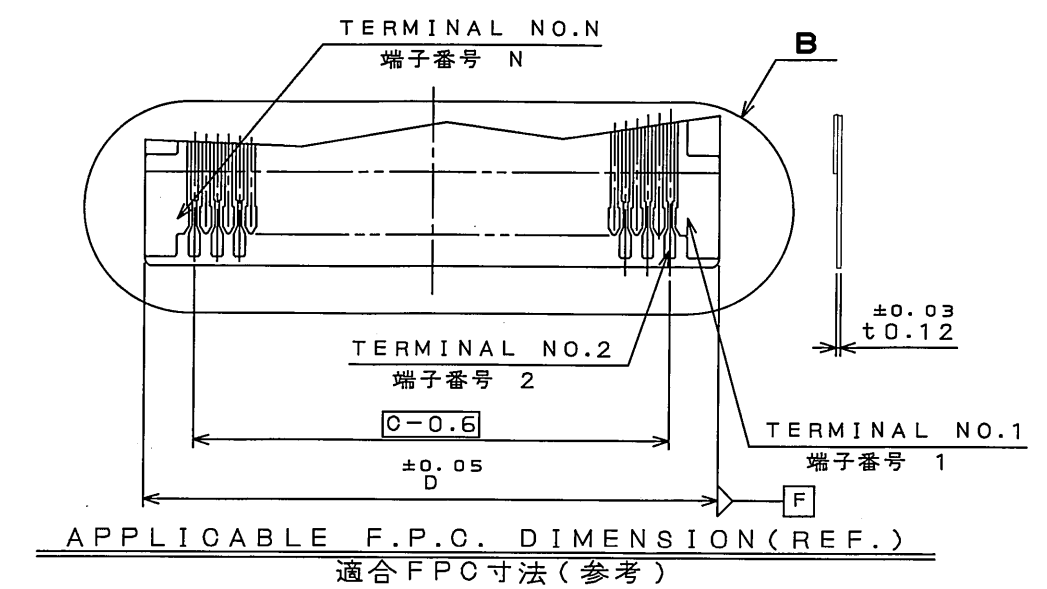
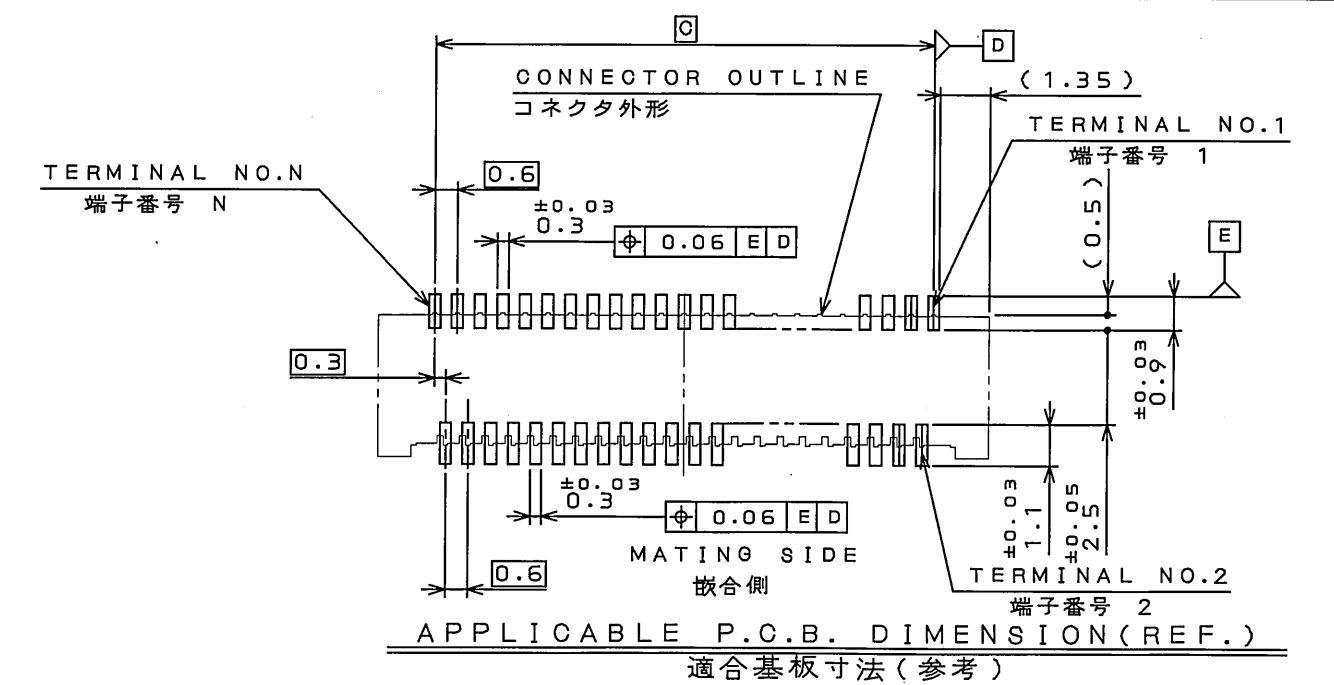


	PRODUCT NO. 品名	A	B	C	D
△	FF028558V1	22.2	21.31	19.2	21.2
	FF028558V1	19.2	18.31	16.2	18.2
△	FF028456V1	16.2	15.31	13.2	15.2
△	FF028358V1	13.2	12.31	10.2	12.2
△	FF028338V1	12.6	11.71	9.6	11.6
△	FF028318V1	12.0	11.1	9.0	11.0
△	FF028298V1	11.4	10.51	8.4	10.4
△	FF028278V1	10.8	9.91	7.8	9.8
△	FF028258V1	10.2	9.31	7.2	9.2
△	FF028178V1	7.8	6.91	4.8	6.8
△	FF028158V1	7.2	6.31	4.2	6.2



NOTE 1. REFER TO TABLE2 ABOUT RCOMMENDED FPC COMPOSITION.
NOTE 2. TOERANCE OF DIMENSION D IS
RECOMMENDED TO BE ± 0.05 IN ORDER TO
IMPROOVE PRECISION OF PITCH POSITIONING
AND CONNECTION RELIABILITY.
NOTE 3. LOT NUMBER IS MARKED ON THE TOP CENTER
PORTION OF THE CONNECTOR.

COMPOSITION 層名		RECOMMENDED 推奨
GOLD PLATING 金めっき	ELECTROLYSIS PLATING 電解めっき	0.1 μm MIN
NICKEL PLATING ニッケルめっき	ELECTROLYSIS PLATING 電解めっき	SOFT TYPE IF AVAILABLE
COPPER 銅箔	ROLLED MATERIAL 圧延銅	NOMINAL 18 μm MAX
ADHESIVE 接着剤	THERMOSETTING ADHESIVE 熱硬化性	NONE (RECOMMENDED)
BASE FILM ベースフィルム	POLYIMIDE ポリイミド	25 μm
ADHESIVE 接着剤	THERMOSETTING ADHESIVE 熱硬化性	30 μm MAX
REINFORCE PLATE 補強板	POLYIMIDE ポリイミド	—



4	ACTUATOR アクチュエータ	1	P P S	_____	COLOR:BLACK/色相:黒 UL94V-0	
3	BASE INSULATOR ベースインシュレータ	1	L O P	_____	COLOR:WHITE/色相:白 UL94V-0	
2	CONTACT 2 コンタクト 2	(N-1) 2	C O P P E R A L L O Y 銅合金	PARTIAL GOLD OVER NICKEL(AVG.1mm MIN.) ニッケル上部分金(AVG.1mm 以上)	_____	
1	CONTACT 1 コンタクト 1	(N+1) 2	C O P P E R A L L O Y 銅合金	PARTIAL GOLD OVER NICKEL CONTACT(AVG.0.3mm MIN.) ニッケル上部分金 接触部(AVG.0.3mm 以上)	_____	
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS	
仕様書(SPECIFICATION)		第1版(ORIGINAL DATE) 14.Jul.2005		尺度(SCALE)	シリーズ(SERIES)	日本航空電子工業株式会社
JACS-10293-*		製図 DR.	_____	5:1	FF02S	JAPAN AVIATION
一般公差(GENERAL TOLERANCE)		担当 CHK.	K.INOUE	名称(TITLE)	FF02S**SV1	ELECTRONICS
寸法(DIMENSION)		査閲 APPD.	_____	(ODD NUMBER OF CONTACTS)		INDUSTRY, LTD.
角度(ANGLES)		承認 APPD.	O.HASHIGUCHI	(奇数芯数)		
. ±0.8 × ±0.4 ×× ±0.1 ××× ±				質量(MASS)	図面番号(DRAWING NO.)	版数 (REV)
					SJ104079	3

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9